В. А. Булатов, Ю. В. Щапова Институт геологии и геохимии им. академика А. Е. Заварицкого УрО РАН e-mail: vladislavtalica@mail.ru

## АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ И ПОКРЫТИЙ МИНЕРАЛОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЗОНДОВЫМИ МЕТОДАМИ

Поверхностные слои минералов и материалов могут существенно отличаться от объема по составу, структуре и свойствам. Минеральные поверхностные покрытия образуются за счет компонентов минерала-хозяина и таким образом анализ поверхности минералов может быть флюидов, реконструкции геологических обстановок. В использован для материаловедении целенаправленная модификация состава и структуры приповерхностных слоев и создание на их поверхности тонких пленок, гетероструктур, наноразмерных образований является одним из инструментов управления функциональными свойствами. Отработка и совершенствование методик исследования состава и структуры тонких пленок и покрытий является актуальной задачей.

настоящей работе отработана методика В комплексного анализа химического состава и структуры пленок толщиной порядка первых единиц мкм на кристаллических и стеклообразных подложках методами электроннозондового микроанализа (ЭЗМА) на микроанализаторе Cameca SX100 и конфокальной микроспектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС) на спектрометре Horiba LabRam HR800 Evolution. На примере пленки состава MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> с примесями (Fe, Ni, Ti, Ca и др.) переменной толщины (1-3 мкм) на поверхности кварцевого стекла, полученной методом магнетронного напыления, оптимизированы операционные параметры оборудования; оценены

<sup>©</sup> Булатов В.А., Щапова Ю.В., 2022

возможности и ограничения методики.

В методе ЭЗМА толщина анализируемого слоя зависит от глубины электронов, области проникновения первичных размера генерации рентгеновского излучения характеристических линий, коэффициента поглощения и глубины выхода характеристического излучения. Выполнены расчетные оценки и измерения зависимости толщины анализируемого слоя от ускоряющего напряжения (U = 5 ÷ 20 кВ), тока и диаметра пучка пленки MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>. Согласно расчетам, количественный анализ пленки толщиной 2-3 мкм возможен при U в диапазоне 5 ÷ 20 кВ, как и для образца сравнения – монокристалла MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, тогда как при толщине ~1 мкм – только при  $U = 5 \div 7$  кВ. Экспериментально содержание основных элементов определялось по линиям Ка, для примесных элементов при снижении U ниже удвоенного значения края поглощения элементов – по Lα линиям. Ток зонда и время сбора сигнала были оптимизированы с целью получения необходимого отношения сигнал/шум и сохранения аналитических характеристик метода в условиях малого объема анализируемого вещества и низкого U, расфокусировку пучка проводили для обеспечения сохранности пленки в течение единичного анализа. Экспериментально установлено изменение вида зависимости отношения Al/Si интенсивности сигнала в области аналитических эмиссионных линий при варьировании ускоряющего напряжения при переходе от пленки толщиной 3 мкм к пленкам толщиной 1-2 мкм (рис. 1). Химический состав пленок толщиной 2 и 3 мкм согласуется с данными синтеза и соответствует составу MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> с примесями (Fe, Ni, Ti, Ca и др.); слабый сигнал Si Ka, соответствующий 0,08 и 0,62 мас.% Si при толщине пленки 2 и 3 мкм, соответственно, интерпретирован как связанный с возбуждением характеристической флуоресценции из подложки.

Для обеспечения высокой поверхностной чувствительности метода КРС оценена зависимость степени конфокальности спектрометра от операционных параметров с использованием зеркальной поверхности кристалла Si, обладающего высоким сечением КРС и малой глубиной проникновения света

42

 $\sim 1/\alpha = 1/11.2 \cdot 10^3$  см<sup>-1</sup>  $\approx 900$  нм ( $\alpha$ -коэффициент оптического поглощения при длине волны λ~514 нм). С учетом полученных данных выбор лазерного излучения 514 нм, объектива 100X/NA = 0,9, значения конфокального отверстия 30 ÷ 100 мкм при анализе пленок MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> обеспечивал пространственное разрешение по глубине от 2 мкм; шаг сканирования ПО глубине составлял 0,3 ÷ 1,0 мкм. Типичный 2D-массив спектров КРС системы пленка MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> + подложка SiO<sub>2</sub>, измеренный послойно в направлении от поверхности покрытия, z = 0 мкм, вглубь образца до z = 14 мкм (рис. 2) имеет суперпозиционную структур при  $z = 0 \div 5$  мкм; спектры более глубоких слоев соответствуют спектру кварцевого стекла. Для получения необходимого отношения сигнал/шум измерения проводили при достаточно больших значениях времени сбора сигнала и количества накоплений (~40 мин на 1 слой). Спектры пленки, восстановленные ИЗ суперпозиционных спектров, удовлетворительно описываются максимумами 555, 647, 732, 775 см<sup>-1</sup>, характерными для структуры частично обращенной шпинели; высокие значения ширины FWHM пиков (~100 см<sup>-1</sup>) указывают на ее значительное структурное разупорядочение.

Таким образом, на примере пленки MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> с примесями (Fe, Ni, Ti, Ca и др.) переменной толщины (1–3 мкм) отработана методика анализа химического состава и структуры поверхностных слоев минералов и материалов. В общем случае оптимальные условия анализа определяются не только толщиной, но и свойствами покрытия, в частности, в методе КРС – сечением рассеяния пленки и подложки, перекрытием их спектров; возможен анализ субмикронных покрытий.

43





Рис. 1. Отношение Al/Si интенсивности сигнала в области аналитических эмиссионных линий при варьировании ускоряющого напряжения в монокристалле MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> (1) и пленках MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> на SiO<sub>2</sub> толщиной 3 мкм (2), 2 мкм (3), и 1 мкм (4)

Рис. 2. 2D-массив спектров КРС пленки MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> толщиной 3 мкм на SiO<sub>2</sub>, нормированных на интенсивность линии D<sub>1</sub> кварцевого стекла при 487 см<sup>-1</sup>

Работа выполнена в рамках Государственного задания ИГГ УрО РАН (темы № АААА-А18-118053090045-8 и № АААА-А19-119071090011-6) на оборудовании ЦКП «Геоаналитик» ИГГ УрО РАН. Дооснащение и комплексное развитие ЦКП осуществляется при финансовой поддержке гранта Минобрнауки РФ (№ 075-15-2021-680). Авторы благодарны коллегам из ФТИ УрФУ Кирякову А. Н. и Зацепину А. Ф. за предоставленные тестовые образцы пленок.